

先端半導体デバイスの基礎と応用小特集編集委員会

情報化社会の進展は、半導体集積回路・半導体デバイスの技術進歩無しには望めません。また、将来の知識基盤社会の 構築にも、半導体デバイスの革新的な進歩に期待が寄せられています。微細化の限界を打破するためのシリコン ULSI デ バイス技術, 通信容量を格段に飛躍させる化合物半導体デバイス, 新機能を創出する量子効果デバイスなど, 半導体デバ イスの大きな挑戦が進んでいます. 最近では、化合物半導体とシリコンの融合集積化も研究が進められています. このよ うな背景から、最先端半導体デバイスの研究動向を紹介することを目的に『先端半導体デバイスの基礎と応用』と題して 小特集(2025年9月号)を企画致しました.多くの方々の積極的な御投稿をお願い致します.

1. 対象分野

- 集積回路及び先端集積化技術
- ・集積回路プロセス技術
- ・高周波デバイスと回路応用
- ・パワーデバイス
- ・ワイドバンドギャップ材料とデバイス ・量子効果デバイス, 単電子デバイス
- ・新しい材料、デバイス、回路
- ・半導体デバイス応用技術

- ・MOSFET, バイポーラトランジスタ, 集積デバイス
- ・化合物半導体材料とデバイス応用
- ・マイクロ波/ミリ波デバイス
- ・TFTの材料・デバイス・応用
- ・評価技術・シミュレーション技術
- ・センサ・ディスプレイ

2. 論文の執筆と取扱い

通常の英文論文と同一です。刷り上がりペーパー8ページ、ブリーフペーパー4ページ以内(厳守)を原則とします。 詳細は Information for Authors (http://www.ieice.org/eng/shiori/mokuji es.html) を御参照下さい. 査読後の再提出期間(通常 は60日)を短縮する場合がありますので、あらかじめ御了承下さい、投稿方法は下記を御参照下さい。

3. 投稿方法

査読作業の円滑化を図るため、本小特集では論文の電子投稿を行います.以下の手順で御投稿下さい. https://review.icice.org/regist/regist bascinfo e.aspx より登録を行って下さい. また、Web 上で著作権の譲渡手続きを行って 下さい. なお登録時には必ず"Journal/Section"で[Special-FU] Fundamentals and Applications of Advanced Semiconductor Devices を選択して下さい. [Regular-EC]を選択しないで下さい.

4. 論文投稿締切日 2024年8月31日(十) 厳守

5. 問合せ先

二瀬 卓也 (ウェスタンデジタル)

E-mail: takuya.futase[atmark]wdc.com

6. 小特集編集委員会

委員長/ゲストエディタ:宇佐美達矢(ラピダス)

幹事:二瀬卓也(ウェスタンデジタル)

委員:平野博茂(タワーパートナーズセミコンダクター), 野田泰史(パナソニック), 細井卓治(関西学院大), 池田浩也(静大),浦岡行治(奈良先端大),大野裕三(筑波大),岡田浩(豊橋技科大),葛西誠也(北大), 小林伸彰(日大), 佐久間究(キオクシア), 佐道泰造(九大), 品田高宏(東北大), 須原理彦(東京都立大), 田中一(阪大),野口隆(琉球大),野村晋太郎(筑波大),平本俊郎(東大),松田直樹(産総研),宮崎誠一(名大), 森貴洋(産総研)、諏訪智之(東北大)

7. 重要なお知らせ

- ・論文採録の場合は掲載料が必要となりますので、あらかじめ御了承下さい.
- ・AWAD2024 で発表された論文を含め一般投稿を広く受け付けます.
- ・投稿に際しては、著者のうち少なくとも1名は本会会員でなければなりません。ただし招待論文に関してはこの限りで はありません.必要な投稿資格を満たしていない著者からの投稿論文については、投稿を受け付けないこととなります ので御注意下さい. 入会の案内はこちらを御覧下さい.

http://www.ieice.org/jpn/nyukai/index.html